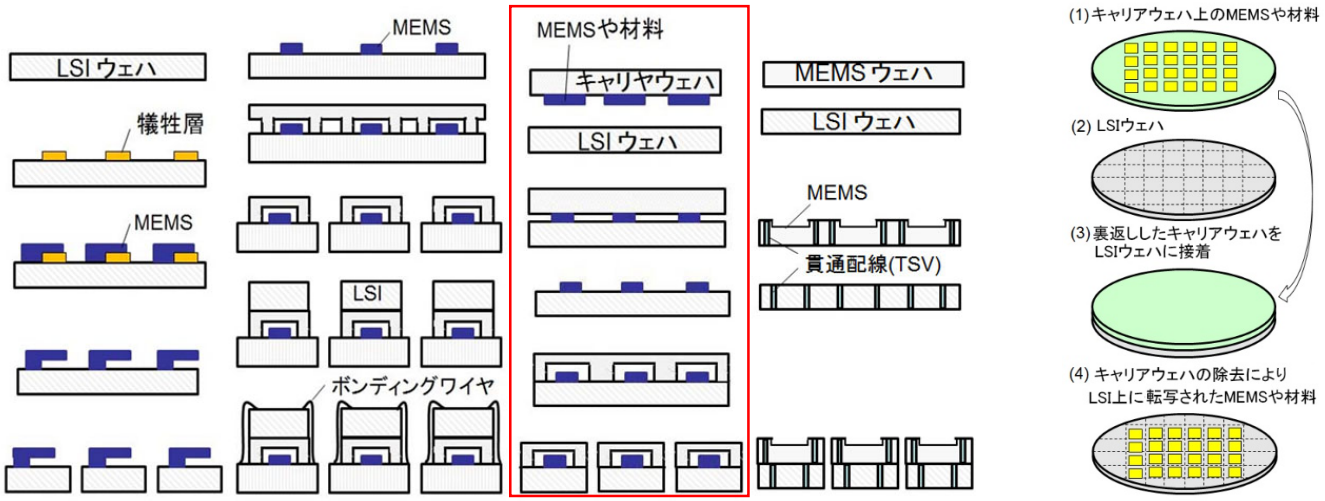
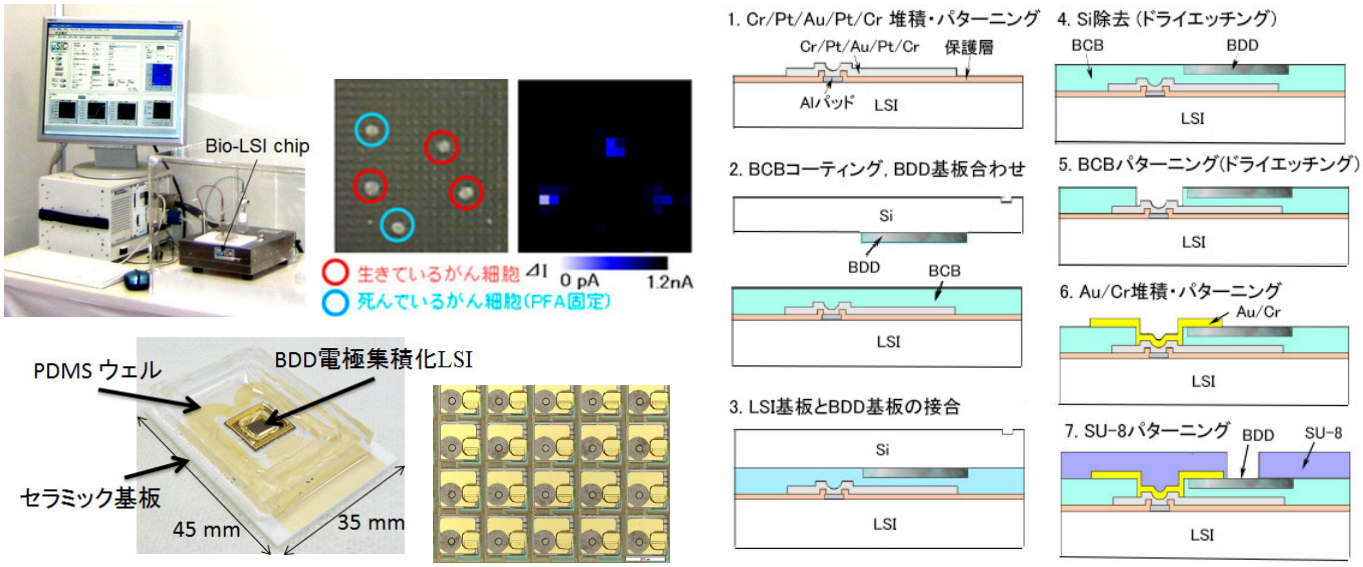
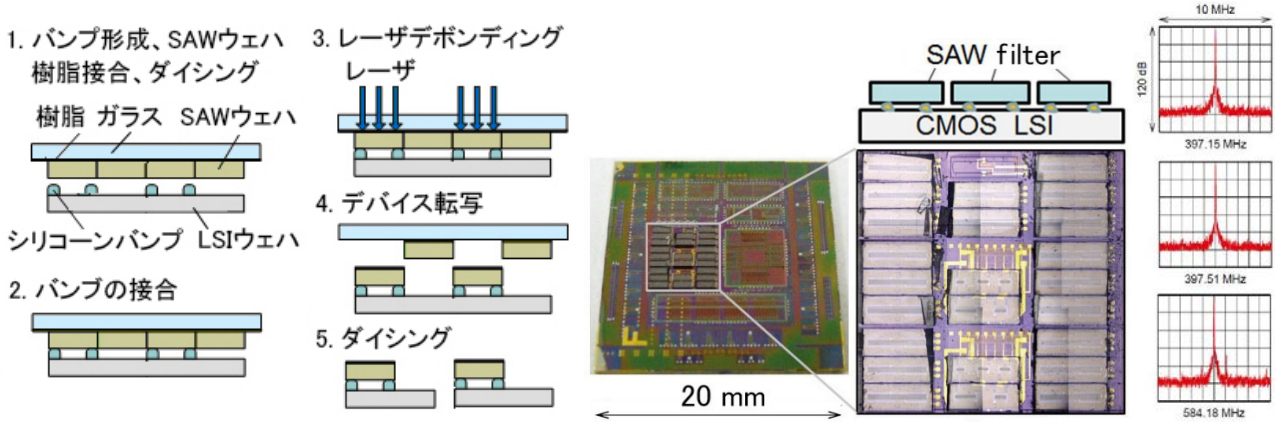
12 LSI 上への MEMS の転写によるヘテロ集積化



(a) 表面マイクロマシニング (b) 別チップの MEMS と LSI の組立（配線の制約） (c) LSI 上への MEMS や材料の転写 (d) 貫通配線(TSV)による接続



ボロンドープダイヤモンド(BDD)膜を LSI 上に転写したバイオ LSI（末永教授）



選択転写工程とそれを用いた LSI 上マルチ SAW フィルタ